

G12 DETALLES O PARTES CONSTITUTIVAS DE INSTRUMENTOS

G12B DETALLES O PARTES CONSTITUTIVAS DE INSTRUMENTOS O DETALLES O PARTES CONSTITUTIVAS COMPARABLES DE OTROS APARATOS, NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR

Notas

- (1) La presente subclase cubre únicamente los detalles que no están limitados a los instrumentos de medida o a todo aparato cubierto por una sola subclase.
- (2) La presente subclase no cubre:
 - los detalles cubiertos por una de las subclases de las secciones A, F, G o H. En particular, los detalles que están limitados a los instrumentos de medida están cubiertos por las subclases apropiadas de G01, p. ej. G01D;
 - los detalles estructurales limitados a los aparatos eléctricos, p. ej. cajas, blindajes, que están cubiertos por H05K o las subclases correspondientes de la sección H.
- (3) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al título de la sección G, especialmente en lo que se refiere a la definición de la expresión “medida” en la nota (2) que sigue al título de la clase G01.

Esquema general

ELEMENTOS SENSIBLES QUE PRODUCEN UN MOVIMIENTO O UN DESPLAZAMIENTO; DETALLES DE MOVIMIENTO.....	1/00; 3/00	GUARNICION O SOPORTES; ELEMENTOS INDICADORES	9/00; 11/00
REGULACION DE LA POSICION O DE LA ACTITUD; COMPENSACION DE TEMPERATURA.....	5/00; 7/00	VERIFICACION	13/00
		REFRIGERACION; PANTALLAS	15/00; 17/00
		DETALLES DE APARATOS QUE EMPLEAN TECNICAS DE BARRIDO CON SONDAS	21/00

1/00	Elementos sensibles capaces de producir un movimiento o un desplazamiento con fines no limitados a la medida; Mecanismos de transmisión asociados correspondientes	9/04	. . Detalles, p. ej. cubierta
1/02	. Bandas o placas compuestas, p. ej. bimetálicas (termómetros que utilizan elementos bimetálicos G01K 5/62)	9/06	. . . Cajas metálicas
1/04	. Cuerpos huecos que tienen partes deformables o desplazables bajo el efecto de la presión, p. ej. tubo de Bourdon, fuelles (fuelles en general F16J 3/00)	9/08	. Soportes; Dispositivos para el transporte
		9/10	. . Cuadros de instrumentos; Paneles; Pupitres; Soportes; Bastidores
3/00	Detalles de movimientos no previstos en otro lugar (detalles de aparatos que emplean técnicas de barrido con sonda G12B 21/00; amortiguamiento de choques o de vibraciones en general F16F; medios para evitar el desequilibrio de fuerzas F16F 15/00; ensayo de equilibrado G01M) [1,7]	11/00	Elementos indicadores; Su iluminación
3/02	. Inmovilización de movimientos, es decir, bloqueo de movimientos cuando no son utilizados	11/02	. Escalas; Cuadrantes
3/04	. Suspensión (cojinetes F16C)	11/04	. Indices; Mecanismos de regulación correspondientes
3/06	. Reducción de los efectos de fricción, p. ej. por vibración (por lubricación F16N)	13/00	Verificación de instrumentos o aparatos (verificación de instrumentos de medida G01)
3/08	. Amortiguamiento de movimientos, p. ej. para evitar las oscilaciones en el momento de la lectura	15/00	Refrigeración (por refrigeración, p. ej. circulación de un fluido refrigerado, F25D; detalles de intercambiadores de calor o de dispositivos de transporte de calor de aplicación general F28F)
3/10	. . que utilizan las corrientes de Foucault	15/02	. por sistemas de circulación de fluido en circuito cerrado
5/00	Regulación de la posición o de la actitud, p. ej. nivel de instrumentos o de otros aparatos, o de sus partes constitutivas (niveles <u>en sí</u> G01C 9/00); Compensación de efectos de inclinación o de aceleración, p. ej. para aparatos de óptica	15/04	. por corrientes de fluidos, p. ej. aire, en circuito abierto
7/00	Compensación de efectos de temperatura (por enfriamiento G12B 15/00)	15/06	. por contacto con masas absorbentes o radiantes del calor, p. ej. baño refrigerante
9/00	Guarnición o soportes de instrumentos o de otros aparatos	17/00	Pantallas (aislamiento u otras protecciones de edificios E04B; protección de emergencia de aparatos en general F16P 7/00; relativas a las ondas sonoras G10K 11/00; relativas a las radiaciones nucleares G21F)
9/02	. Cajas; Guarnición; Habitáculos (dispositivos de estanqueidad para los órganos de transmisión F16J, particularmente F16J 15/50)	Nota	
		El presente grupo <u>cubre</u> :	
		– la protección de instrumentos u otros aparatos contra las radiaciones u otras influencias exteriores;	
		– las medidas preventivas contra la emisión de radiaciones indeseables u otras influencias por los instrumentos u otros aparatos.	
		17/02	. contra los campos eléctricos o magnéticos, p. ej. ondas radio

G12B

- 17/04 . contra la luz visible ultravioleta, o infrarroja (pantallas para dispositivos de iluminación F21V; filtros ópticos G02B 5/20)
- 17/06 . contra el calor (G12B 17/04 tiene prioridad; refrigeración G12B 15/00)
- 17/08 . contra las influencias que producen deterioros mecánicos, p. ej. causados por una explosión, por un objeto exterior, por una persona (G12B 17/02 a G12B 17/06 tienen prioridad)
- 21/00 Detalles de aparatos que emplean técnicas de barrido con sonda [7]**

Notas

- (1) En este grupo la siguiente expresión se usa con el significado indicado: [7]
- “sonda” se refiere a un dispositivo de interfaz, p. ej. una aguja de punta aguda, que define una zona transductora donde se produce una interacción, p. ej. la generación de una corriente por efecto túnel cuando la sonda se halla muy cerca de una superficie [7]
- (2) Es importante tener en cuenta las notas siguientes a los títulos de la clase B81 y de la subclase B81B relativas a “dispositivos de microestructura” y “sistemas de microestructura” y las notas siguientes al título de la subclase B82B relativas a “nanoestructuras”. [7]
- (3) A continuación se ofrece una lista de lugares en los cuales se indican aplicaciones específicas que utilizan técnicas de sonda de barrido: [7]
- B82B 3/00 Fabricación o tratamiento de nanoestructuras

- C23C Tratamientos superficiales de materiales metálicos
- G01B Medida de dimensiones
- G01N 13/10 Investigación o análisis de la estructura a escala atómica de una superficie
- G11B 9/12 Registro o reproducción de información
- G11B 11/24 Tubos de descarga provistos de medios que permiten la introducción de objetos o de un material para ser expuestos a la descarga
- G11B 13/08
- H01J 37/00
- H01L Procesos o aparatos especialmente adaptados a la fabricación de dispositivos semiconductores o de estado sólido
- 21/02 . Sondas [7]
- 21/04 . . Sondas de efecto túnel [7]
- 21/06 . . Sondas ópticas de campo cercano [7]
- 21/08 . . Sondas de fuerzas atómicas [7]
- 21/10 . . Sondas de fuerzas magnéticas [7]
- 21/12 . . Sondas de fuerzas electrostáticas [7]
- 21/20 . Disposiciones para el barrido o el posicionamiento [7]
- 21/22 . . Detalles estructurales [7]
- 21/24 . . Compensación de los errores provocados por la temperatura o las vibraciones [7]